

平成17年度秋季全国大会フォーラム論文募集

主 題：エレクトロニクス実装技術動向と今後の展開
－環境配慮型車載用電子実装から次世代パワー
エレ実装の展開まで－

座 長：高橋康夫（大阪大学）、藤本公三（大阪大学）

開催趣旨

エレクトロニクス実装は、IT 革命、環境革命の牽引役として、今後益々必要になることは疑う余地がない。地球環境保全と快適な生活の享受の両立には、エレクトロニクスのさらなる発展が必要である。エネルギー制御、発電、蓄積、電力消費、輸送操縦等の最適化に不可欠なパワーエレクトロニクスは、電力化率の増大とともに、益々重要になると考えられる。小は数 mA のモバイル機器、IT 機器から、産業用、自動車（車載）用電子機器実装の裾野はより広く且つ高信頼性を必要となってきた。民生用、家庭用機器に比べ動作環境のきびしい車載用、産業用電子実装に的を絞る。鉛フリーはんだ適用現状とその高信頼性確保のための技術動向、また、超高信頼性インターコネクション技術等を中心にエレクトロニクス実装の動向と問題点並びに今後の展開を議論する場として、本フォーラムを企画開催する。できれば、近未来に不可欠な環境低負荷次世代パワーエレクトロニクスの主役として期待されているスーパーパワーデバイス周りの配線実装技術動向をも展望する。

予定討議項目：

1. 産業用機器電子実装における鉛フリーソルダリング技術動向
2. 環境配慮型低公害車における電子実装と今後の展望
3. 車載用電子実装の信頼性とその技術動向
4. 車載用電子実装とパワーエレクトロニクス最前線
5. その他、カーエレクトロニクス、産業機器用高信頼電子実装の必要性

記

日 時：平成17年9月22日 13:00～17:00

場 所：福井大学（福井市）

申込方法：著者名、タイトル、概要（200字程度）、所属、連絡先を明記し、Fax（03-3253-3059）にて、溶接学会事務局へお申し込みください。

申込締切日：平成17年4月1日

講演採否：直接申込者に連絡致します。

講演論文原稿送付締切日：平成17年7月8日

注) 採択された講演者には、原稿を、所定様式により作成し上記送付期限までに提出していただきます。提出して頂いた原稿は、溶接学会全国大会講演概要集 No.77 に掲載させていただきます。原稿作成・講演方法等の詳細は座長（高橋康夫）より連絡致します。